



第 24 届中国国际光电博览会将于 9 月 6-8 日在深圳国际会展中心隆重举行，CIOE 同期信息通信展将重点打造半导体及光通信智能装备馆 (10 号馆)，其中将重点展出半导体制造设备、封装设备、测试设备，如晶圆切割机、AOI 检测设备、智能分选设备、耦合机、固晶机、划片机、点胶贴片机等。

部分参展企业如 Raith、SENTECH、Samco、寰鼎集成、阿尼拉数控、泰络、吉永商事、创世杰、柏昆、华年风、ADT、和研、大族半导体、纬迪、圣昊光电、京创先进、思达优、亿博、先普、华邦、益思迪、ASM AMICRA、MRSI(Mycronic Group)、Finetech、恩纳基、先进光电、耀野、芯图、艾科瑞思、三吉世纪、微见、中电科第二研究所、翼龙、讯速信远、锐博、尚进、汉先、大成、优炜芯、马舍科技、吾拾微、新微细线、E-Globaledge、ficonTEC、兴启航、北科、镭神、光泰、中科光智、奥特恒业、艾科威、达姆、米艾德、赛科、中南鸿思、京信科、博测、和林微纳、科信机电、雅科贝思、骏河精机、德瑞精工、三英精控、微纳精密、明察智识、攀特电陶、得地为业等都将带来相关产品（排名不分先后）。光博君整理了部分企业展品，更多持续更新中，敬请期待！

E-Globaledge Corporation

展位号: 10D92

所属展区: 信息通信展



公司简介:

E-Globaledge Corporation 针对客户需求定制化的高精度贴片设备和高低温测试设备&成像传感器产品的有源对准贴装设备，并推荐全新技术的 EBL 设备 CABL-AP50，其继承自可控制 0.01nm 间距并在光通讯领域 DFB EML 和啁啾激光量产市占率最高的 CABL-9000C 系列设备。同时也有超高分辨率和 130kV 加速电压的 CABL-UH EB 光刻设备可供选择。

光通讯以及数据中心使用的芯片相关的加工设备



产品介绍:



针对 LD 芯片的生产工艺，我司将介绍面向 COB 及 COS 产品的高精度贴片设备以及 能够对 LD 芯片或 COS 产品进行高低温测试以及对应的贴装设备。可以按 客户的需求进行定制。在制作光栅工艺中，我们将推荐 Crestec 生产的 CABL-9000C 系列目前已实现了能控制 0.01nm 级的间距，并已实际应用在光通讯领域占有 最高份额的 DFB 以及 EML 产品的量产使用。我们并接受 EBL 写光栅的委托加工业务， 请随时与我们联系。

光通讯以及数据中心使用的芯片相关的加工设备



产品介绍：

针对 LD 芯片的生产工艺，我司将介绍面向 COB 及 COS 产品的高精度贴片设备以及能够对 LD 芯片或 COS 产品进行高低温测试以及对应的贴装设备。可以按客户的需求进行定制。在制作光栅工艺中，我们将推荐 Crestec 全新技术的 EBL 设备 CABL-AP50，其继承自可控制 0.01nm 间距并在光通讯领域 DFB EML 和啁啾激光量产市占率最高的 CABL-9000C 系列设备。同时也有超高分辨率和 130kV 加速电压的 CABL-UH EB 光刻设备可供选择，请随时与我们联系。

先进微电子装备（郑州）有限公司

展位号: 10C35

所属展区: 信息通信展



公司简介:

2003 年，先进切割技术有限公司 Advanced Dicing Technology Co., Ltd（简称 ADT），脱胎于美国 K&S 公司 30 余年根植切割设备及刀片领域的技术积累及业务传承，成为一家以色列的高科技公司。2019 年，以光力科技 GL Tech 为龙头，联合若干中资机构完成对 ADT 公司的 100% 股权收购，新 ADT 诞生。2020 年至今，新 ADT 以河南郑州为公司总部及研发生产基地；以色列 Yokneam 为海外研发生产基地；以上海浦东为销售中心布局全球业务。



新 ADT 作为 100%中资企业，全力助力半导体设备国产化事业，打破国际设备厂商垄断地位，已成为国内客户设备国产化替代的首选品牌之一。

半自动单轴 6 吋晶圆切割机



产品介绍：

ADT 6110 是一款高精度，高性能单轴半自动切割机。占地面积小到极致，结合全新设计的操作系统，提供高效、低使用成本的切割体验。标准配置 2.2kw 高转速主轴，θ轴采用 DD 马达驱动，并搭载自动校准，自动切割，刀痕检查功能。可选配搭载残片形状识别，指定检查位置一键直达等功能。适用于精密加工晶圆、陶瓷、玻璃、碳化硅等各类半导体材料。

半自动单轴 4 吋大直径刀头切割机



产品介绍：

ADT 7134 是一款高精度，高效率的单轴切割机。搭载业内仅有的 4 吋主轴，配合 4~5 吋刀片，适用诸如陶瓷基板、氧化铝、各类合成物、厚膜器件等多种产品的切割。切割深度可达 6mm 以上。2.5kw 高功率空气悬浮式主轴，最高 30KRPM 转速。直流无刷式马达提供闭环转速控制。可切割最大 12"圆形工件产品，或 12"*9"方形贴膜产品，或 12"*12"方形无环产品。

全自动双轴 12 吋切割机





产品介绍:

ADT 8230 是一款高效率、高性能、低成本的双轴（对向）全自动晶圆切割机。最大切割工件尺寸可达 12 英寸。支持最大 3 英寸刀片，可选择 1.8KW 或 2.2KW 大功率主轴。使用 17 英寸触摸显示屏，操作界面直观。最新开发的图形用户界面集成了面向客户使用的快捷操作功能。设备搭载快速自动对齐、切割定位等功能，具备高精度自动刀痕检测和切割质量分析能力。广泛应用于晶圆、各类封装、分立器件以及 MEMS 等半导体产品的精密切割。

中国电子科技集团公司第二研究所

展位号: 10D35

所属展区: 信息通信展



公司简介:

中国电子科技集团公司第二研究所成立于 1962 年，是我国以智能制造、微电子装备及应用、碳化硅装备及应用、新能源装备及应用等产品研发生产的骨干单位。二所是科技部“国家第三代半导体技术创新中心（山西）”、科技部“国家科技合作基地”、工信部“智能制造试点示范”、国防科工局“军用微组装技术创新中心”、山西省“宽禁带半导体制备重点实验室”、山西省“微组装工程技术研究中心”山西省“微电子智能制造装备创新中心”等的主建和依托单位。近年来，获得国家级、省部级奖项 11 项。

全自动共晶贴片机



产品介绍:

本设备专用于 TO（晶体管外形）型激光器的全自动共晶贴片。从 TO 管控的上料开始，经过晶圆上料、精密平台校准、SUB（热沉）共晶贴片、LD（激光二极管）芯片共晶贴片，到成品下料，以流水线方式完成 TO 器件的热沉与 LD 芯片贴片生产工艺。此设备具有高速、高精度的特点，实现了复杂时序、严密逻辑的工艺过程。设备采用凸轮驱动、连杆联动、精



密夹具等结构，配合多轴运动控制、视觉定位等技术，具有批量生产能力。

平行缝焊机



产品介绍:

该设备主要用于微电子器件、光电器件等较大管壳的气密性缝焊。

MRSI (Mycronic Group)

展位号: 10B79

所属展区: 信息通信展



公司简介:

MycronicAB 是一家在纳斯达克斯德哥尔摩上市从事生产设备开发、制造和销售的瑞典高科技公司，满足电子行业高精度和灵活性的要求。Mycronic 集团旗下的 MRSI Systems 是全自动、高速、高精度、灵活多功能的贴片系统的全球领先制造商，为所有级别的封装提供最有效的系统和组装解决方案。迈锐斯自动化（深圳）有限公司是瑞典 Mycronic AB 在中国注册的独资子公司，是 MRSI Systems 在中国地区业务本地化的战略举措，公司与 MRSI 深圳产品演示中心合址，并使用 MRSI 品牌。迈锐斯除延续 MRSI 在中国地区的业务，也将进行本土化的应用产品开发，为客户提供更多的封装应用解决方案与更优质的服务。

MRSI-H-HPLD+1.5 微米贴片机



产品介绍:



MRSI-H 系列为真正的多芯片、多工艺、多产品大批量高混合生产提供了被验证了的卓越的灵活性。这些高速产品提供业界领先的速度，而不牺牲灵活性，精度或可靠性。MRSI-H 系列是应对 5G 无线网络的推出和高增长的高功率半导体激光二极管(HPLD)市场带来的制造业的挑战。根据应用，MRSI 将 H 系列重新分类。

MRSI-S-HVM 0.5 微米贴片机



产品介绍:

MRSI-S-HVM 可用于半导体晶圆级封装，可实现多芯片、多工艺在一台机器上生产。两种精度自动切换模式: ± 0.5 微米 @ 3σ , ± 1.5 微米 @ 3σ , Z 轴向力控制的贴片模式, 高压力功能可选。

- 适用于(CoW), (CoI), 硅光封装, Co-packaging;
- 支持多工艺
- 不需要额外的参考点或校准。晶圆平台具有自动调平功能。
- 自动吸头切换和双龙门/贴片头结构。
- 材料输入方法: wafer, Waffle pack, Gel-Pak®, 以及定制的夹具。

MRSI-HVM 系列 1.5 微米贴片机



产品介绍:

MRSI-HVM 产品系列以其领先的速度，吸嘴间的“零时间”切换和小于 1.5 微米贴片精度被公认为业界领先的一流贴片机。其双机头、双共晶焊接台、“零时间”吸嘴转换系统的配置，超快速共晶焊接温度的升降以及多层次多功能并行工艺自动化处理,实现了 MRSI-HVM 产品系列卓越的性能。MRSI-HVM 专为特定应用而设计，包括使用共晶和/或蘸胶工艺的 CoC 封装、CoS 封装和 CoB 封装。



恩纳基智能科技无锡有限公司

展位号: 10D31

所属展区: 信息通信展



公司简介:

恩纳基智能 (ENERGY INTELLIGENT), 团队包括西安交通大学、哈尔滨工业大学、东南大学等知名院校的半导体设备行业优秀经营管理及技术研发人员, 团队希望将领先的智能交互技术和创新型公司运作经验与中国优秀的人才和广阔的市场相结合, 打造一个业界一流, 互利共赢的智能装备及远程维护系统解决方案公司。 作为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业, 恩纳基专注服务于广泛应用于功率模块、光通讯、传感器、微波、激光雷达等先进封装领域, 为用户提供更柔性、更稳定、更精准、更优性价比的智能装备。目前已成功研发八大系列产品, 并进入一线用户产线, 成为多家著名企业的半导体设备供应商。

AOI 智能外观检测设备



产品介绍:

1、A18 主要检测 Wafer 上的芯片, 在执行芯片外观检测的同时可根据需要选配自动对焦功能、拾取力控制功能、芯片分选功能。 2、A18Plus 以检测装片、焊线后芯片为主, 搭载自动上下料模组, 检测精度高, 速度快, 检测能力稳定。 3、A18Pro 采用线扫视觉系统, 主要检测 4 英寸、6 英寸、8 英寸玻璃片、IR 片、硅片。

T18 (D) 高精度智能贴装装备



产品介绍:



硬件配置：1、设备最高精度达 $\pm 3\mu\text{m}@3\sigma$ ，配置高精度校准平台及底部相机，芯片外观检测功能，芯片位置及角度校正功能 2、具备双工作平台，采用点、画、蘸胶独立控制系统，胶量控制更加精确可靠，可根据客户需求定制 3、通用式自动上下料平台、适用于不同类型的 Wafer、Tray 等定制类型料盘 4、采用音圈电机可自动校正焊头、确保贴片过程中力控的稳定性 软件功能： 1、高精度芯片搜索平台、自动扩晶系统 2、采用多款配置，设备结构模块化管理，满足客户各种软性化定制

S17 高精度智能分选设备



产品介绍:

应用领域： 光模块 MEMS 等各类芯片分拣、表面缺陷检测领域

设备尺寸： W1100*D950*H1650mm $\approx$ 700Kg (S17) W1400*D1900*H1750mm $\approx$ 1700Kg (S17 Plus) W1500*D1200*H1750mm $\approx$ 2000Kg (S17 Pro) 最高精度： 分拣精度 ± 25 微米，角度 $\pm 2^\circ$ 功能优势： Wafer-Tray、Tray-Wafer、Wafer-Wafer； 尺寸，外观缺陷检测； Mapping 计数&分选； OCR 字符识别；

东莞市耀野自动化有限公司

展位号: 10C26

所属展区: 信息通信展



公司简介:

耀野自动化致力于光器件自动化耦合、组装、检测设备的开发和销售。核心研发团队成员均毕业于知名高校。目前可以向客户提供：硅光产品耦合机、同轴器件耦合、COB 器件耦合、透镜耦合、全自动滤光片贴装、3um 固晶机、光学影像测量等自动化设备。经过多年的持续改进，我们的设备在效率、精度、稳定性等方面已经处于行业领先水平。

COB 耦合机



产品介绍:

兼容 40G/100G/400G SR4、SR8、FA、AWG 类产品耦合。XYZ Θ 四轴自动耦合、自动多通道均衡、自动点胶、自动 UV 固化。另外可提供双耦合台的 25G COB 器件专用机器，同时耦合两个透镜。

透镜耦合机



产品介绍:

用于各种高精度透镜 (LENS) 耦合，XYZ 三轴由直线电机+光栅尺组成，分辨率 5 纳米,重复定位精度 20 纳米。自动拾取透镜，自动耦合，自动点胶，自动分段 UV 固化。具备全自动视觉定位，真空机械二合一透镜夹，均为行业先进水平。有伺服电机版的低成本方案供选择。

高精度固晶机 (3 微米)



产品介绍:

固晶精度 3 微米(3Sigma)，兼容点胶和共晶工艺，兼容晶圆环和料盒，可以同时安装 6 个晶圆。



河北圣昊光电科技有限公司

展位号: 10D51

所属展区: 信息通信展



公司简介:

公司成立于 2017 年, 位于河北省石家庄市, 是专业致力于半导体光通信芯片测试设备、化合物芯片划/裂片设备及其相关产品的研发制造; 提供激光器、探测器、双抛片的分割、外观、光电性能测试等代工服务的高新技术企业和国家重点专精特新小巨人企业。 公司主营产品核心技术、关键零部件、软件、算法、材料全部自主研发、生产, 拥有自主知识产权, 产品完全替代进口, 打破国际垄断, 真正实现了光电芯片检测设备国产化。 公司秉承创新发展的理念; 坚持科技兴业、技术兴企方略; 坚持标准引领, 加快科技创新; 坚持产品标准化与个性化定制相结合, 研发制造高精度、专业化的设备和提供优质的芯片加工服务。 智造成就光芯, 合作共赢未来!

LD 芯片测试机



产品介绍:

LD 芯片测试机用于对 LD 芯片的电气和光学特性进行检测、判定与分选。主要包含 DFB 芯片低温/高速双温测试机、DFB 芯片高频特性测试机、EML 芯片测试机、COC 特性测试机和大功率芯片测试机。该系列产品具有测试速度快、温控精度高, 测试数据的再现性和相关性稳定可靠、数据准确等优点。 ◆发散角测试(选配): 快轴发散角 测试范围: $\pm 60^\circ$ 慢轴发散角 测试范围: $\pm 60^\circ$ 分辨率: 0.072° ◆电机驱动测试模式: (1) 普通 LD (DFB) 模式 (2) LD+EA 模式 (3) LD+SOA 模式 (4) LD+EA

LD/PD 芯片划片机



产品介绍:

LD/PD 芯片划片机是主要用于化合物半导体材料（砷化镓、磷化铟等）芯片在常温条件下的对位、相机定位，同时完成砷化镓芯片的划切功能。划刀荷重分段测量，更稳定，更精确的表示当前荷重，自动模式和手动模式相机辅助效果良好。

Bar 条测试机



产品介绍:

激光器 Bar 条全自动测试机全自动上下料，支持多种规格的积分球、多种规格和多种波段的 LD 测试系统，支持多种规格料盒上料，支持多种规格料盒和蓝膜下料。测试温度用户自定。单或双探针加电，测试 NG chip 采取打点标记，向用户开放测量数据库，用于后续筛分工序。

深圳市锐博自动化设备有限公司

展位号: 10C71

所属展区: 信息通信展

REB 锐博

公司简介:

深圳市锐博自动化设备有限公司是一家从事半导体封装领域设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司有 600 平米标准装配车间，来料检验室，标准件仓库，设备精调车间，设备展示厅，大理石校准台，2.5 次元测量设备及微米级激光干涉仪，有优秀的工程研发团队及售后团队，目前有研发工程师本科以上学历 15 人，全部来自国内知名一本院校，工程经理 3 人，行业经验 10 年以上，在他们的带领下保证了公司各个基础研发项目有序推进。

超声波金属焊接机 UT-400



产品介绍:

UT-400 是 IGBT 端子焊接制程中，加压机于金属端子并通过超声波高频振动使端子与底板键合的生产设备。设备采用 200*300mm 载盘，通过更改载盘和少部分零件即可切换生产产品。

全自动 TO56 共晶机 ET-501P



产品介绍:

ET-501P 是将热沉 (Submount) 与芯片(LD)，经过加热键合在 TO56 管座上的专用生产设备。

自动点胶贴片机 DB-560P



产品介绍:

DB-560P 是 COB/COC 制程中将基底(PCB 或其他待加工材料)与芯片，经过点胶工艺键合的生产设备。

微见智能封装技术（深圳）有限公司

展位号: 10B69

所属展区: 信息通信展





公司简介:

微见智能封装技术（深圳）有限公司成立于 2019 年 12 月，是专业从事高精度复杂工艺芯片封装设备研发和生产的高科技企业。微见拥有高精度芯片封装工艺、高精度机械运控平台、机器视觉和算法、高精度工艺模组等全套自主核心技术。微见 1.5um 级高精度固晶机已经成功量产并规模商用，设备拥有 COC/COS、GOLD BOX、AOC/COB、TO、RF/Hybrid Device、Fan-out、Flip chip 等工艺能力，支持环氧树脂等胶工艺、共晶工艺、烧结工艺，支持 TCB 热压焊、超声焊、激光焊等技术方向，支持第三代半导体芯片（氮化镓 GaN、碳化硅 SiC）封装工艺需求。

多功能高精度固晶机 MV-15D



产品介绍:

微见智能 MV-15D 同时具备共晶，蘸胶，点胶，UV 等工艺能力，支持蓝膜，Gel pack/waffle pack，轨道等上下料方式，支持多芯片应用，可自动更换大于 13 个不同类型的吸嘴。灵活的应用软件系统支持不同产品应用，工艺应用自由切换，不需要额外的软硬件校验。兼容 COC/COS，COB，BOX 等各种封装形式。该设备可广泛应用于光通信、激光雷达、5G 射频、商业激光器等多个领域，是芯片封装过程中不可或缺的工艺设备。

高速高精度固晶机 MV-15H



产品介绍:

微见智能高速高精度固晶机 15H 双工位协同工作，效率提升 50%，该设备为 2022 年最新研发新品，专为光通讯、大功率商业激光器，激光雷达等高精度高可靠性 COC/COS 共晶封装应用量身定制，是芯片封装过程中不可或缺的工艺设备。

高速高精度固晶机 MV-15T

**产品介绍:**

三工位协同工作，是专为 COB 及 BOX 封装量身定制的胶工艺应用高效率专用设备，在满足高精度，高效率的同时，MV-15T 同时兼具灵活性。支持多芯片贴装，点胶/蘸胶系统，物料转运系统，贴装系统均支持多个吸嘴/胶头的自动更换，是芯片封装过程中不可或缺的工艺设备。

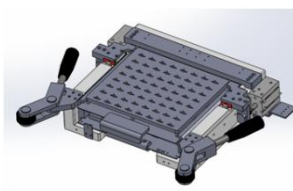
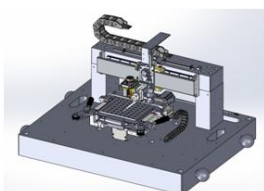
深圳市兴启航自动化设备有限公司

展位号: 10D71

所属展区: 信息通信展

**公司简介:**

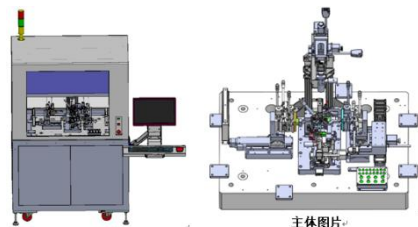
深圳市兴启航自动化设备有限公司成立于 2014 年，在国内拥有完善的销售及售后服务体系！覆盖全国范围。公司专业从事光通信自动化系列设备和重要技术突破的研究开发；2021 年建立“兴启航智能装备（江门）有限公司” 拥有 5000 多平米生产基地，为企业发展提供充足场所；公司主营业务包括自动化设备和自动化产线的研发、生产及销售。研发团队由多名对光通信行业产品工艺、机械设计、软件开发有丰富经验的高级工程师组成。

TO56 盘测机**产品介绍:**

兴启航 TO 盘测机是一款针对同轴激光器耦合前分选 TO56 终测性能指标而开发的一款设备，解决目前 TO56 性能离散性大，在耦合激光焊接时效率低、产品一致性差的问题；TO56 盘测机精准测量 TO56 焦距及性能测试（MPD 暗电流、PIV、光谱、跳模、光束偏转角、四向性）；自动筛选分 BIN；采用料盘上下料，一次可测 64 颗料；UPH（纯焦距测试）：350pcs/H



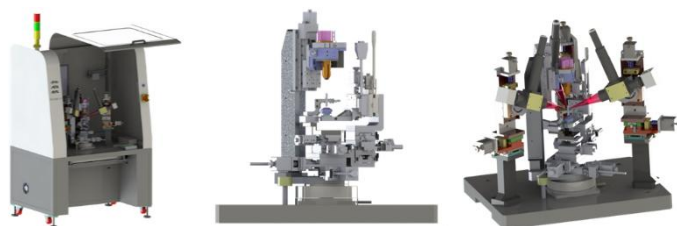
LENS 自动耦合系统



产品介绍:

兴启航 LSOH005 自动耦合设备是一款广泛应用在光通信行业光器件生产的设备;适用产品: BOX 100G/200G TOSA/ROSA lens 耦合、BOX 25G TOSA/ROSA lens 耦合; 气浮减震、XYZ 轴进口高精滑台、弧摆感应贴平, lens 和芯片位置、胶水高度 CCD 自动识别功能; EML 温控加电功能可选; TOSA、ROSA 两套软件(中文可编程软件)及电路可选。软件单路峰值、四路均衡算法、兼容大小光耦合可选。产品的耦合焊接数据,保存在本地电脑,方便用户上传数据及 MES 操作。

四件式耦合机



产品介绍:

兴启航四件式耦合机 DTL003 自动耦合设备适用产品: combopon1577 TO、插针和 base 的耦合焊接, TO、TOSA 管体、调节环和插针的耦合焊接; 气浮减震、两组 XYZ 轴进口高精滑台、弧摆感应上下面贴平; EML 温控加电功能可选; 中文可编程软件。 软件单路峰值、兼容大小光耦合可选。产品的耦合焊接数据,保存在本地电脑,方便用户上传数据及 MES 操作。

德瑞精工(深圳)有限公司

展位号: 10C55

所属展区: 信息通信展





扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

公司简介:

1、德瑞精工（深圳）有限公司向各行业提供标准直线电机、模组以及定制化运动平台。 2、总面积 15000 m²，目前人员 258，研发占比超 35%。 3、产品已应用于半导体、激光、检测、LED、SMT、新能源、光学、医疗等多个行业。 4、销售网络国内覆盖华南、华东、华北、华中，为区域内客户提供专业、高效的服务。

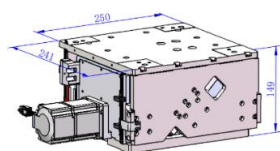
XYθ平台



产品介绍:

1.应用在微动对位调整平台 2.XYθ直驱平台系列产品之一，一共三个系列，此规格为 120*120*75(H)，还有 65*65*52(H)，200*200*75(H)可选 3.直驱设计，闭环反馈，精度优于普通螺杆微调台，标配光栅，可达到±1um 重复精度，旋转重复精度角秒级。 4.模块化设计，可以自由多轴组合或单轴购买

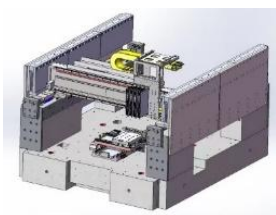
高刚性精密 Z 轴升降台



产品介绍:

定制平台，应用于探针台、晶圆检测等对 Z 轴空间有限制的场合 负载：20kg，有效行程：30mm，重复精度：±0.5μm，定位精度：3μm（补偿）速度：250mm/s，加速度：0.2g

大理石双驱龙门平台



**产品介绍:**

1、高精度大理石平台，应用与半导体高精度行业 2、紧凑型 Z+R 拾取机构 3、Z 轴定位精度 2μ 、重复定位精度 $\pm 0.5\mu$ 4、旋转轴定位精度 $\pm 0.06^\circ$ ，重复定位精度 $\pm 0.005^\circ$ 5、半导体芯片的（开环力控）拾取和贴装、键盘按压测试、触控面板测试、开关检测、液体配剂量/注入、微组装（摄像头模组等微小零件、寿命/疲劳性测试 6、可根据客户需求定制

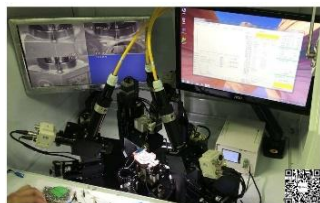
湖南中南鸿思自动化科技有限公司

展位号: 10D25

所属展区: 信息通信展

**公司简介:**

湖南中南鸿思自动化有限公司是一家为光电子企业提供专业的自动化生产装备及方案的厂商，公司围绕客户需求持续创新，加大研究投入，厚积薄发，致力于实现光电子器件全自动化生产。公司成立于 2015 年，位于美丽的星城长沙，孵化于高性能复杂制造国家重点实验室，创始人均来源于中南大学的博士团队。该团队从 2008 年开始便致力于开发应用于光电子封装的相关设备，目前已完成同轴型激光器/探测器自动耦合设备、COB 光模块自动耦合机、蝶形器件自动耦合机、FAC 自动耦合机、反射镜自动耦合机、COS 及焊料自动贴装机、工业泵浦源测试/老化设备，以及其它各类定制化设备的研发和推广。

25G 同轴型激光器/探测器自动耦合焊机**产品介绍:**

25G 同轴型激光器/探测器自动耦合焊机用于自动化生产全金属封装的 TOSA/ROSA，采用智能算法，具有耦合效率高、速度快、质量高等优点。此外，通过夹具替换，其衍生机型可适用于 100G-BOX 四件式、200G/400G 光斑-功率、ComboPon 等多种器件结构的自动耦合。

BOX 封装微透镜耦合设备



产品介绍:

设备功能：用于 100G 及以上多载波模块中 BOX 封装光器件的矩形准直透镜的全自动耦合。可以自动完成亚毫米尺度透镜的拾取、姿态调整、耦合、点胶及固化。具有光斑和功率多种耦合手段。采用直线电机驱动滑台，具有精度高速度快的特点。

单通道 COB 封装耦合设备



产品介绍:

设备功能：单通道 COB 自动耦合机主要用于生产 10G 或 25G 单收单发 COB 模块，采用 UV 固化模式，可以同时双 Lens 进行耦合，并同时固化封装。Lens 采用导向插光纤机构，夹紧同时自动穿入陶瓷插芯，无需人工手动插 LC 插芯。

北京三吉世纪科技有限公司

展位号: 10D61

所属展区: 信息通信展



公司简介:

公司总部位于北京，其前身为三吉电子（北京）有限公司成立于 1993 年，2003 年公司经改组更名为北京三吉世纪科技有限公司。公司自成立至今始终致力于将欧美的先进电子生产、半导体制造设备及工艺介绍到国内，成为多家欧美半导体设备制造商的中国代理。超强的本土化技术服务队伍为客户及时提供全方位的售后服务并为客户的工艺疑难问题提供总体解决方案。在业内享有良好的声誉。产品涉及半导体芯片制程、混合电路的封装和测试、



电子装配、表面防护及可靠性试验。客户遍布航天、航空、电子、通讯、船舶、汽车、医疗及大专院校等。

VEECO 平行封焊机



产品介绍:

Model 2400e 平行缝焊机系列产品的设计可针对管壳类产品进行气密封装。按您所需将密封良率提高到最高，并提高生产率。数字化缝焊系统，控制精度、可加工所有类型气密封装，灵活性高，系统兼容能力强。可应用在 SMD 石英晶体元件（晶振）、声表滤波器（SAW）、光器件、混合集成电路（HIC）：微波及 DC-DC 转换器模块、传感器（MEMS）等领域。

PARYLENE 镀膜设备



产品介绍:

真空气相沉积的 Parylene 涂层，它是一种绝缘材料，其特性适合电路板的涂层要求。Parylene 是热塑性聚酯材料大家庭中的一员，它是一种气态沉积，而非传统的喷或浸的方式。这些透明的薄膜是一种链状结构，在单位厚度具有较好的介电强度及阻滞性能，同时具备良好的化学惰性及无针孔性。较薄的涂层对基体体积的增加很小，不会象液态涂层那样，在角落发生堆积，在器件之间产生桥接。传统涂层由于其体积的变化，在温度产生变化时，往往会产生机械应力。

金属剥离湿法设备



产品介绍:



金属剥离湿法设备在一个完全封闭的全自动系统中将浸没式批浸泡处理和单晶片溶剂喷涂处理相结合。功能应用包括金属剥离、光刻胶剥离，助焊剂去除等，用于 Si 晶片和包括 GaAs、InP、GaN、GaP 等 III-V 系半导体、以及蓝宝石、SiC 和玻璃晶片。

深圳市益思迪科技有限公司

展位号: 10D029、10D030

所属展区: 信息通信展



公司简介:

益思迪 TM 科技有限公司是一家专注提供防静电咨询和解决方案的高新技术企业，同时对高端的防静电材料、防静电仪器进行开发、生产、销售。在德国，深圳，上海，东莞，湖南均有研发中心，拥有一流的国际专家和研发团队。集团拥有自己的知识产权，并获得多个防静电产品专利,已经成为领先的防静电解决方案供应商。

晶元切割膜类



产品介绍:

ES04 系列 为是一款晶圆切割专用胶带，采用软质复合薄膜为基材，用于晶圆/LED 切割固定，该产品具有良好的柔软性，抗残胶及防静电性能

智能 ESD 仪器



产品介绍:

EI 系列双回路接地监控仪主要用于监控 EPA 区域防静电工作台的手腕带、台垫、设备的接



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

地状况, LCD 显示实时显示监控阻值,监控的数据可通过 WIFI 网络传输。

自吸附包装盒



产品介绍:

EX61 系列 是一款采用特殊高分子胶水,胶体透明,网格印刷在胶底部,不影响胶体表面粘性,具有优异的吸附性,保证运输周转过程中,器件不移动,真空状态下表面粘力降低,便于自动化设备取放。

镭神技术(深圳)有限公司

展位号: 10C75

所属展区: 信息通信展



公司简介:

镭神技术(深圳)有限公司自 2017 年 10 月成立伊始,核心研发团队来自于光通讯头部企业 Lumentum。在短短六年间,公司成熟设备已达 10 余种。涵盖光器件,探测器件等领域。整机年产能 500 台。 公司聚焦于光电精密自动化领域,掌握了精密贴装,对准耦合和测试老化等专有技术。公司在高速光纤通信模块、硅基光电子模组、高功率半导体激光器、车规级激光雷达模组、3D 成像模组和半导体先进封装测试等市场,为合作伙伴提供完整的解决方案和及时的售前售后服务。 公司有深圳、西安两大研发生产基地,武汉设有销售售后办公室,现有员工 160 人,其中研发 70 人。实现了研发、设计、生产、销售全产业链。

自动光路耦合机



产品介绍:

耦合机,主要的耦合轴高精度的全闭环运动平台能满足不同产品的需求。采用高精度图像辅



助定位系统能消除来料物料差异，提高耦合的速度，同时避免了因来料物料差异过大导致物料与物料之间碰撞损坏产品的风险，并更适合大规模的生产；拥有自动校准定位相机与吸嘴及定位相机与针嘴的功能，降低了调校工程师要求，提高人性化的调校方法，同时规避了一些调校时发生碰撞的风险；在准直镜吸嘴上拥有压力反馈系统能测量准直镜底面与基板上表面的距离，同时规避了损坏准直镜或基板的风险。

广东莱伯通试验设备有限公司

展位号: 10A28

所属展区: 信息通信展

labtone 莱伯通

公司简介:

广东莱伯通试验设备有限公司成立于 2002 年，是一家自主研发、生产制造、销售与服务为一体的高新技术企业。 公司主要产品包括：振动、冲击、碰撞、跌落、综合环境试验系统等：产品广泛应用于军工、航天航空、船舶、汽车、轨道交通、电子电器、电池、通讯设备、包装运输等众多领域的力学环境试验中。 公司秉承“技术研发为基础、以诚信为本、以质量求生存，以服务赢客户”的经营理念，始终坚持核心技术研发，为众多企业提供全方位、多角度、高标准的技术方案与专业服务。

振动试验机



产品介绍:

电磁式振动试验机在实验室条件下模拟振动环境，测试各种振动试验应用领域中的冲击强度和可靠性。在实验室借助振动试验机系统可以模拟再现正弦、随机、谐振搜寻与驻留、典型冲击和道路仿真等模式。对于产品的质量保证、新品研发都是必不可少的。

冲击试验机



产品介绍:

主要应用于：手机、电池、计算机部件、光学部件、连接器等，还可以作为缓冲材料试验机测试缓冲材料的性能。

综合环境试验机



产品介绍:

我们一直关注可靠性试验技术的最新发展,非常重视提高可靠性试验设备技术. “环境仿真”的要求也使客户认识到由一家供应商提供振动台和试验箱以实现完整综合试验的重要性.我们可以依据客户不同的试验需求,提供范围广阔的综合环境试验系统,如三综合、四综合试验设备方案、多轴振动试验系统和最新试验技术。

武汉光圈科技有限公司

展位号: 10C16

所属展区: 信息通信展



公司简介:

武汉光圈科技有限公司是专业从事光通讯行业智能装备研发、制造、工业软件定制、技术服务的高科技企业，产品涵盖自动检测、自动装配和自动下料等成套自动化生产线。目前主推系列产品“光纤绕圈机”（4大系列、10种机型）、“光背板布纤成套设备”、“光纤光栅全自动化生产线”、“光模块全自动检测成套装备”、“激光剥纤机”、全自动光纤无源器件前处理成套装备。公司拥有30多项自主研发的专利和软件著作权，先后通过了ISO9001质



量管理体系认证和国家高新技术企业、国家科技型中小企业、武汉市科技“小巨人”认定，产品得到“华为科技”、“光迅科技”“锐科光纤等行业标杆企业的认同。

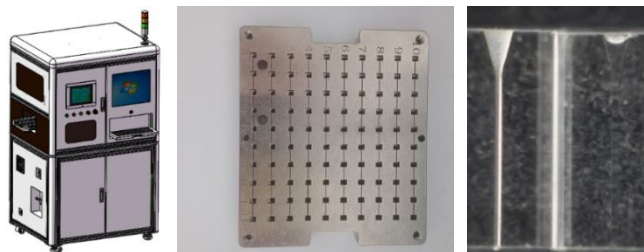
激光剥纤机



产品介绍:

一、行业应用 1、主要用于各种规格光纤的剥纤（涂覆层去除），在光纤任意位置去除，端面或开“天窗”更方便； 2、适用于多种规格的单芯光纤、带状光纤，每种光纤涂层外皮材料不同，通过调整至合适的工艺参数来实现； 二、产品特点 1、非接触式加工，没有机械应力和切痕，不损伤纤芯，无任何损材； 4、质量一致性和可靠性高，成品率高； 5、操作简单，生产效率高，可同时加工多根光纤，节省人工； 7、可对接定制生产流水线。

毛细管视觉定位点胶机



产品介绍:

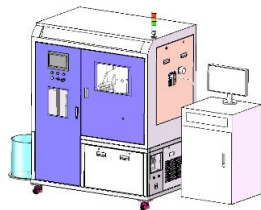
一、行业应用 主要用于各种毛细管点胶，如：方形毛细管 2.5*2.1*4.7、圆形毛细管 $\phi 1*3.2$ 等，亦可以适用于陶瓷插芯点胶。 二、产品特点 1、采用视觉系统定位，高精度模组走位，精准点胶。2、治具中无产品的位置可自动判别跳过。 2、点胶效率高， $\geq 850\text{pcs/h}$ 左右。（人工 200~300PCS/h）3、采用配方式菜单输入界面，操作简单。一次输入保存，重复调用。4、产品更换方便，只需更换相应治具即可。

单纤全自动绕圈贴胶机



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



成品图一

成品图二

产品介绍:

一、行业应用 主要用于对光纤全自动绕圈下料、定长切断，打标贴胶纸，后期使用可追溯场景。 二、产品特点 1、本设备无人值守工作，人机界面上设定长度，产品数量，开始工作至设定产量结束。 2、采用激光标刻，胶带上字迹清晰、条码识别度高。 3、胶纸非常稳定的自动下料，并两头折叠，方便后续扯开（已申请发明专利）。 4、生产过程中无光纤拉伤、划伤问题。 5、操作简单，新手几分钟内可学会并批量生产。

力标精密设备（深圳）有限公司

展位号: 10E31

所属展区: 信息通信展



公司简介:

力标精密设备（深圳）有限公司成立于2018年，是一家专业研发、生产、销售为一体的推拉测试机及力学仪器生产厂商，公司始终坚持“以市场需求为导向，以技术创新为核心”的企业经营理念和发展战略方针，经过多年的努力与发展，目前已成了行业一流测力设备制造商。公司产品已广泛应用于：半导体封装测试、LED封装测试、摄像头模组封装测试、光电传感器件，IGBT功率模块封装测试、光通讯领域、电子器件、汽车领域、航天科研项目、微电子测试领域、大学院校及科研单位等，公司产品已处于同行业高度领先地位，产品也得到了广大客户一致认可与好评。

多功能推拉测试机





产品介绍:

公司产品已广泛应用于：半导体封装测试、LED 封装测试、摄像头模组封装测试、光电传感器件，IGBT 功率模块封装测试、光通讯领域、电子器件、汽车领域、航天科研项目、微电子测试领域、大学院校及科研单位等，公司产品已处于同行业高度领先地位

武汉优炜芯科技有限公司

展位号: 10B73

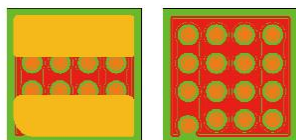
所属展区: 信息通信展



公司简介:

武汉优炜芯科技有限公司，专业的紫外 LED 芯片、器件、模组、光源系统及应用方案供应商，面向全球紫外 LED 方案商和应用公司，提供高性能近紫外 LED 固化光源系统与装备、高质量深紫外 LED 芯片/灯珠/模组与服务，以卓越的科技创新能力打造丰富的紫外行业解决方案，构建开放共赢的产品生态，推动产业规范建设，助力胶水、涂料、油墨紫外固化及医疗美容、植物工厂照明、空气、水、表面杀菌等各行各业实现产业化升级。

UVC 杀菌芯片



产品介绍:

UVC 杀菌芯片具有高功率、高可靠性、耐高温寿命长、环保节能、波长可定制、电压 0.1V 分档等特点，广泛应用于空气/水的杀菌消毒、光学传感器、生物分析/检测、医学光疗、植物照明、药物催化等领域。

UVC 杀菌灯珠



产品介绍:

UVC 杀菌灯珠具有集成高功率、高可靠性、耐高温寿命长、环保节能、应用场景更广等特



性，广泛应用于空气/水的杀菌消毒、光学传感器、生物分析/检测等领域

UVC 杀菌模块



产品介绍:

UVC 杀菌模组具有工业级标准，防水等级 IP68，优良的热学管理，低光衰，寿命长，采用国际先进的 DUV LED 杀菌技术，应用于洗衣机领域。

骏河精机科技（上海）有限公司

展位号: 10C31

所属展区: 信息通信展



公司简介:

骏河精机自 2011 年 7 月在中国成立了总部——骏河精机科技（上海）有限公司，自此开启了中国制造业添砖加瓦的旅程。在中国，已有 100 家以上国内著名大型厂商采用骏河的产品，从而构筑了行业先驱的地位。骏河精机的品质毋庸置疑，近年来核心技术在应用系统端进行了更大的发展。为了满足不同客户的需求，提供更快捷更优质的服务，骏河精机除了在上海之外，还在深圳设立了分公司，今后我们将陆续在全国各大主要城市中设立销售服务网点，现已经在国内建立制造工厂，为客户提供更加稳定高效的服务。

XYZ 轴直线滚珠导轨





扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

产品介绍:

直线滚珠加丝杆结构，通过复杂的高精度加工和组装，实现微米级定位精度的同时，体积非常小巧。还可以根据客户的个性化要求自由搭配组合，实现客户所需各种功能。

自动滑台耦合组合（6 轴）



产品介绍:

在 XYZ 轴直动 3 轴与 $\theta_x\theta_y\theta_z$ 轴移轴 3 轴上加入自动滑台的组合。可全方向控制，结构对应单芯光纤至光纤排列或光波导及各种光学元件等所有装置的自动耦光用途。除了耦光用途以外，还可以实现 6 维高精度自动调整和自动对位功能，解决客户问题，提高生产效率。

波导耦合（被动元件耦合）系统



产品介绍:

通过为耦合系统专用开发的滑台组合与软件。配合客户的装置，为您提供最适合装置的建议。高速耦合独创算法实现高速化操作性提升。通过对话型介面，提升软件操作性。除此之外，骏河可以根据客户的多样化需求提供个性化的定制解决方案，特别在高精度的组装和测试领域，骏河具有多年的丰富经验和精湛技术，将全力助力于实现工业 4.0 目标。

三英精控（天津）仪器设备有限公司

展位号: 10D66

所属展区: 信息通信展



SYMC

三英精控

公司简介:

三英精控(天津)仪器设备有限公司是一家专注于精密运动控制技术和产品的开发,并致力于为科学研究、创新研发及高端仪器、设备的制造等提供系统的技术解决方案与集成,满足市场对精密运动控制技术需求的专业制造商。三英精控(天津)仪器设备有限公司秉承“高端创新、精益制造”的宗旨和“打造中国高端制造的国际品牌”的目标,为中国制造装备产业升级、转型提供关键技术和打造坚实基础,助力“中国制造2025”。三英精控(天津)仪器设备有限公司在纳米运动控制技术方面具有先进的技术和经验,并具有该类技术的自主知识产权。核心技术集精密传感、精密驱动、精密机械、精密控制、精密集成等各领域的技术于一体,综合技术指标已达到先进水平。

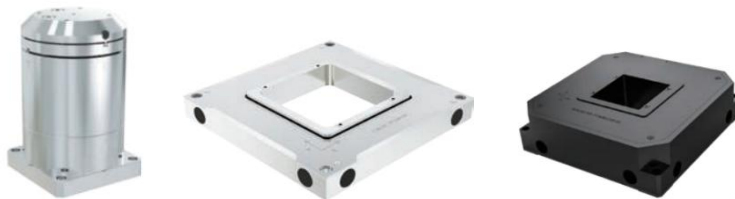
纳米电容传感器



产品介绍:

典型应用:精密制造、计量检测、变形监测、显微镜、材料测试、震动检测。被测物体与传感器各自作为一个平板电极。通过给传感器一个持续稳定的交流信号,其电压的振幅变化与传感器到被测物体之间的距离成正比。交流信号经过解调,可以测出位移量。电容式位移传感器具有信噪比大,灵敏度高,频响宽,非线性小,精度稳定性好,无损耗等特点。

纳米定位平台



产品介绍:

纳米运动控制技术是由光、机、电、控制软件等多领域技术集成的运动控制技术。内部由一



个或多个压电陶瓷作为驱动，其产生单轴或者多轴的运动；通过柔性铰链技术将压电陶瓷产生的运动传递和放大；经超精密电容传感器将运动信息传递给控制系统，再由控制系统对该运动进行修正、补偿和控制；在对运动系统进行闭环控制时，可实现纳米、亚纳米级别的运动分辨率和运动控制精度。

气浮旋转台



产品介绍:

是各种高精度测量、光学测量组装加工、芯片半导体测量加工、全物理仿真模拟设备、超精密加工设备等行业的极佳选择。产品反映了我们对气浮产品设计生产经验和创造性灵感，产品承载大、径向和轴向刚度高、角刚度好、高度低；隔尘设计、温度适应性强，可以适应生产加工环境。

深圳市得地为业科技有限公司

展位号: 10C67

所属展区: 信息通信展



得地为业

公司简介:

深圳市得地为业科技有限公司是一家集光学、自动化控制、精密机械、电子信息于一体的高科技企业,公司致力于建立完善的质量管理体系通过了 GB/T19001 2016/ISO9001:2015 国际质量体系认证,全力打造高标准、高品质、高精度系列化产品。公司自成立以来,全心专注研发生产 1-6 轴精密位移平台,高精度对准系统,经过多年来的潜心研制,已有标准型号 500 余款,包括视觉对位平台、电动平移台、旋转台、角度台、升降台、中空旋转平台、以及紧凑型模组,多款对准系统,并有充足的库存,可及时满足不同客户的不同需求。合作客户包括:大族激光、天孚通信、舜宇集团、华为、富士康、清华大学等。

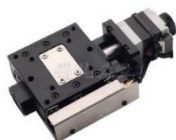
T60-G85FL



产品介绍:

手动微调架 三维 XYZ 一体式微调架 T60-G85FL: ■ 不锈钢/铝合金材质精密加工 ■ 采用弹簧复位, 消除轴向间隙 ■ 微分头在微调架中心和侧面放置, 操作更加方便 ■ 侧面锁紧方式特殊设计, 增强台面锁紧的稳定性 ■ 采用高精度钢丝导轨, 精度更高, 承载较大, 寿命长, 可选配 0.25 螺距的微分头提高定位精度。

HDAS8-60W



产品介绍:

电动角位台 HDAS8-60W: 1) 标配 5 相步进电机和 H12 航空插头连接器, 方便连接控制器 2) 旋转轴系采用多道工艺精密加工而成, 配合精度高, 承载大, 寿命长 3) 采用精密研磨级滚珠丝杆结构, 运动流畅, 可任意正反向旋转且空回极小 4) 设计精巧的消空回结构, 可调整长期使用造成的空回间隙 5) 特殊的结构设计保证了角位台台面极低的偏摆和倾斜, 使运动更加平稳 6) 台面外围的刻度圈是激光刻划标尺, 标尺可相对台面传动, 方便初始定位和读数

FGJ12-33R



产品介绍:

手动六维微调架 FGJ12-33R: ■ 不锈钢材质精密加工 ■ 采用拉伸弹簧复位, 消除轴向间隙, 无空回 ■ 微分头驱动, 分辨率高, 稳定性高 ■ 巧妙的结构设计, 调整方便 ■ 上



下部均有标准孔距的连接孔，方便与其它位移平台连接，组成多维移动台

苏斯微光学股份公司

展位号: 12C816

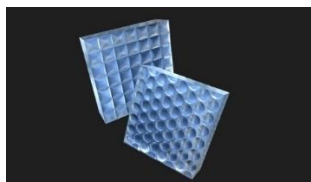
所属展区: 信息通信展



公司简介:

SUSS MicroOptics SA 是全球领先的微光学产品供应商，提供高质量的折射型与衍射型光学产品。公司成立于 1999 年，位于瑞士的纳沙泰尔。在光学设计，微加工及测量方面具有极其丰富的经验。在光通讯及数据中心领域我们为客户提供高质量、可靠的微透镜及微透镜阵列产品；在半导体加工领域，我们的衍射产品应用于光束整形、光束匀化；在汽车领域，压印透镜应用于汽车的前灯及光毯，极大的降低了前灯的尺寸，有效的提高光束的利用率；微透镜阵列还被用于医疗，检测，三维成像等多个领域。

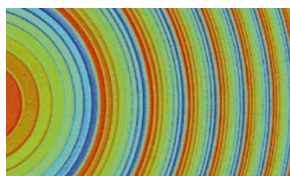
微透镜及微透镜阵列



产品介绍:

高品质微透镜阵列，可用于光通讯，数据中心中光束准直，耦合聚焦；可用于光束整形及光束匀化；可用于 3D 成像及波前检测；可用于内窥镜及医美设备。

衍射光学产品



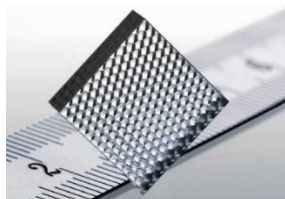
产品介绍:

高衍射效率 DOE 产品，可以按您的设计定制，也可以设计并加工 可加工 2 级，8 级，16 级衍射产品 最小特征尺寸 0.5um



扫码参观登记

压印透镜



产品介绍:

压印微透镜阵列，可用于汽车迎宾光毯，前灯，尾灯等。